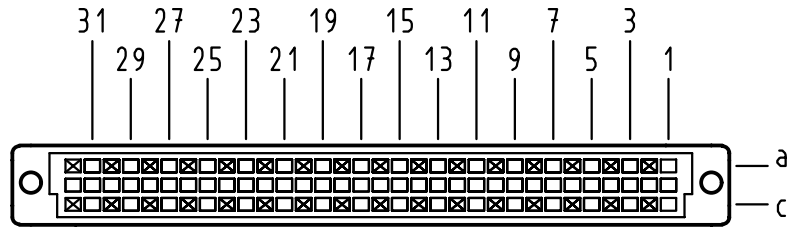


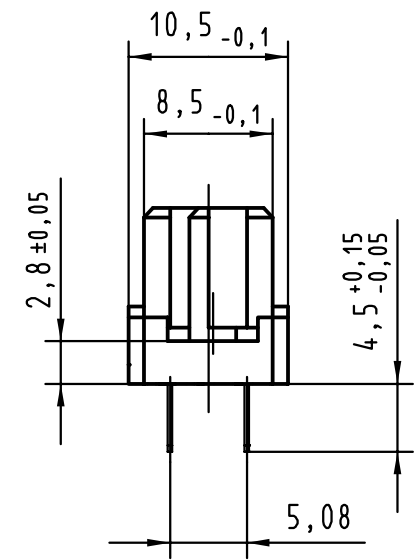
**X**  
Kontaktanordnung  
Contact arrangement



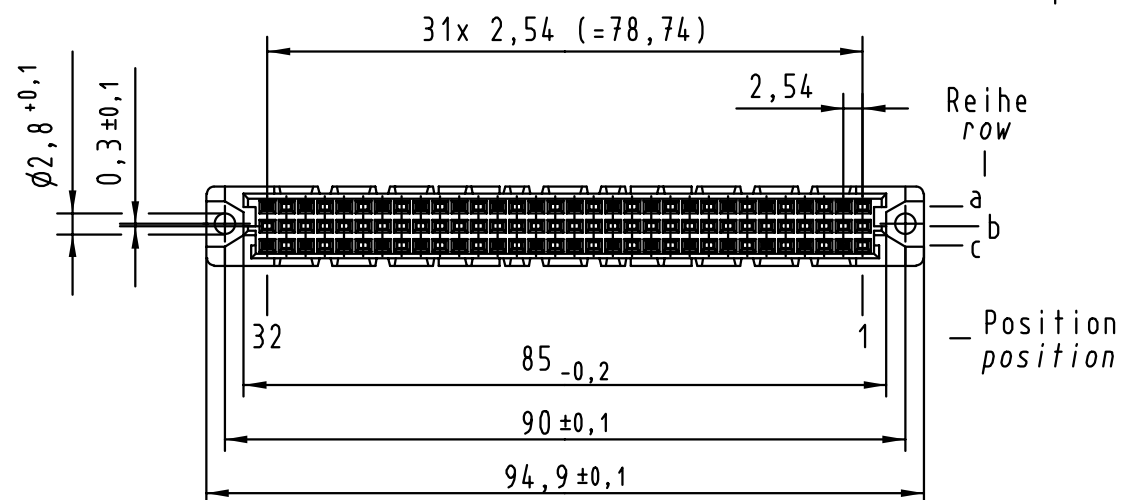
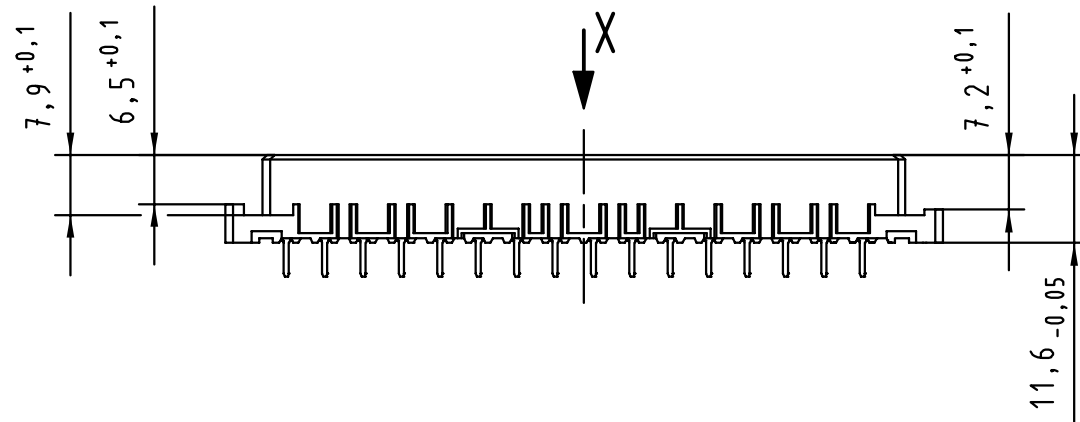
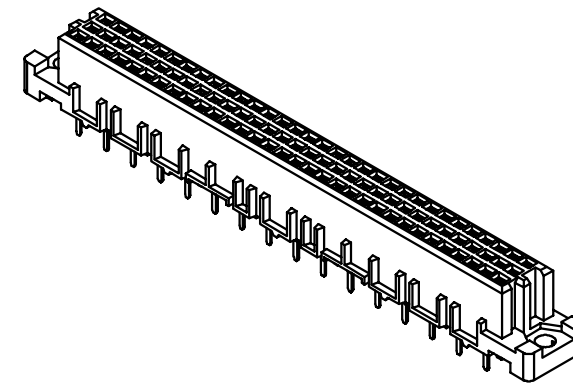
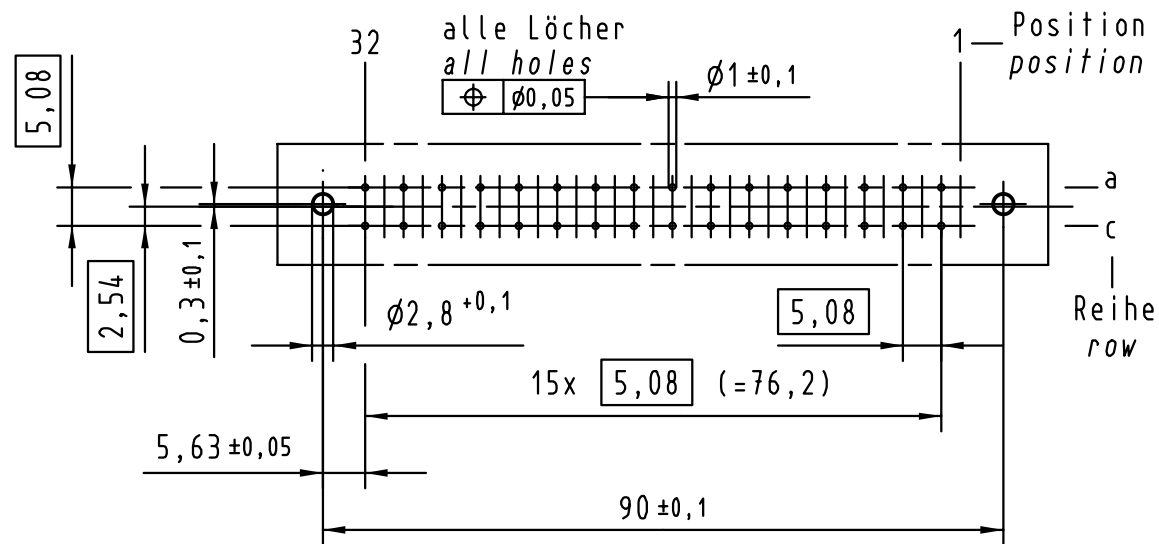
32 Einlöt-Kontakte  
32 solder-contacts

- ☒ = Einlöt-Kontakt  
= solder-contact
- = kinked Einlöt-Kontakt  
= kinked solder-contact
- = Kontaktpositon nicht belegt  
= position without contact

**Z**  
2:1



**X**  
(Lochbild)  
(Board drillings)



09 03 232 5825	-	min. 0,76 μm (30 μm) Au über/over min. 1,27 μm (50 μm) Ni
09 03 232 4825	VG	Au über/over Ni
09 03 232 7825	3	Au über/over Ni
09 03 232 6825	2	Au über/over Ni
09 03 232 2825	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße / Free size tolerances siehe / see IEC 603-2		
26919	12.11.99	Rie.						
26082								
Mod.	Dat.	Name	HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP					TB 09 03 232 x825 Sub.

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved